证券代码：688352　　证券简称：颀中科技　　公告编号：2026-091
转债代码：118059　　转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1.2023 年首次公开发行股份募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用 187,373,816.76 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,232,626,183.24 元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 10 月 15 日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298 号），公司向不特定对象发行 85,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用合计人民币 11,209,905.66 元，实际募集资金净额为人民币 838,790,094.34 元。

上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 11 月 7 日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1.2023 年首次公开发行股份募集资金

截至 2026 年 9 月 30 日，首次公开发行股份募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	余额
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002969	0.00
招商银行股份有限公司合肥分行	551905785910599	30,258,226.70
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010119200439482	0.00
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	8112301011300920979	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801100001630	0.00
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	474179072157	0.00
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600007495	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801000002089	0.00
合计		30,258,226.70

注：中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行 34050144770800002969、中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行 1302010119200439482、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行 8112301011300920979、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801100001630、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 474179072157、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 32250198883600007495、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 89030078801000002089 已销户。

2.2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

截至 2026 年 9 月 30 日，向不特定对象公开发行可转债募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	余额
中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	188783950139	99,440,514.54
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011301139625	27,101,464.99
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	526182906575	530,873.53

存放银行	银行账户账号	余额
首都银行（中国）有限公司上海分行	12100024690020013	107,065,431.73
合计		234,138,284.79

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司招股说明书承诺募集资金全部用于扩展相关业务。2023 年首次公开发行股份募集资金截至 2026 年 9 月 30 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书承诺募集资金全部用于扩展相关业务。募集资金到位后，因实际募集资金净额低于募集说明书拟投入金额，公司于 2026 年 1 月 16 日经第二届董事会第八次会议审议通过，将募投项目拟投入募集资金金额调整为 83,879.01 万元（详见附件 3 注 1），未改变募集资金投向。截至 2026 年 9 月 30 日止，实际投资项目与募集说明书承诺一致，实际使用情况与调整后投资计划一致。具体情况详见本报告附件 3 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

本公司前次募集资金置换情况如下：

1.2023 年首次公开发行股份募集资金

公司于 2023 年 6 月 2 日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,345.32 万元及已支付发行费用 527.99 万元。

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换。截至 2026 年 9 月 30 日，公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为 75,325.76 万元。

2.2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

2026 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 9,331.00 万元。

2026 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，使用自有外汇支付部分募投项目所需资金，再以募集资金等额进行置换。截至 2026 年 9 月 30 日，公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为 6,271.99 万元。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1.2023 年首次公开发行股份募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募投项目均已结项。截至 2026 年 9 月 30 日止，募集资金账户余额为 3,025.82 万元，其中：未使用募集资金金额为 1,506.78 万元，占前次募集资金总额的比例为 0.62%。募集资金账户余额与未使用募集资金金额差异为净利息收入支出差额。

公司结项的募投项目在实施过程中，遵守募集资金使用的有关规定。加强项目成本费用的控制和管理，形成资金节余。2024 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“颀中先进封装测试生产基地项目”和“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”结项后的节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，公司于 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065），并明确实际节余金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司“颀中先进封装测试生产基地项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项。截至 2026 年 9 月 30 日止，募集资金账户余额 3,025.82 万元，其中待支付给供应商金额 79.26 万元，预计节余资金 2,946.56 万元，计划用于永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项。截至 2026 年 9 月 30 日止，募集资金账户余额 0.00 万元，募集资金账户节余资金 89.23 万元已用于永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司“颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项。“颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”节余资金 481.75 万元，单个募投项目节余金额低于

1,000 万元，根据《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》第十九条及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，可以免于履行董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司已履行内部审批程序，并于 2026 年 3 月将该笔节余资金转出用于永久补充流动资金；其使用情况将在公司 2026 年年度报告中披露。截至 2026 年 9 月 30 日止，募集资金账户余额 0.00 万元，募集资金账户节余资金 481.75 万元已用于永久补充流动资金。

2025 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日、2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）、《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-031）。截至 2026 年 6 月 17 日，公司本次股份回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-060）。截至 2026 年 9 月 30 日止，公司超募资金所在募集资金账户余额 0.00 万元。

2.2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

截至 2026 年 9 月 30 日止，公司 2025 年向不特定对象公开发行可转债募投项目均未结项。截至 2026 年 9 月 30 日止，可转债募集资金账户余额为 23,413.83 万元，其中：未使用募集资金金额为 23,182.77 万元，占前次募集资金总额的比例为 27.27%。募集资金账户余额与未使用募集资金金额差异为净利息收入支出差额。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 和附件 4 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目以公司为实施主体，加大研发投入，有利于提升公司产品质量及生产效率，丰富公司产品结构，提升公司市场竞争力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金及偿还银行贷款将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

颀中先进封装测试生产基地项目累计实现效益 92.70 万元，承诺的累计效益为 32,981.73 万元；主要系自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施，受限于设备境外采购及供应商的产能因素，设备交付较原预计时间有所延后，且客户认证周期较长，受此影响，公司募投项目建设进度在一定程度上有所延缓。项目原计划于 2023 年 9 月完成，延期至 2024 年 12 月，2024 年和 2025 年均处于产能爬坡阶段，因此未能实现预计效益。2026 年 1-9 月，随着客户的持续导入，项目当期实现效益 9,517.71 万元。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2023 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书以及向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．前次募集资金（2023 年首次公开发行股份募集资金）使用情况对照表

2．前次募集资金（2023 年首次公开发行股份募集资金）投资项目实现效益情况对照表

3.前次募集资金（2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金）使用情况对照表

4.前次募集资金（2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金）投资项目实现效益情况对照表

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

附件 1

合肥颀中科技股份有限公司

前次募集资金（2023 年首次公开发行股份募集资金）使用情况对照表

截止日期：2026 年 9 月 30 日

编制单位：合肥颀中科技股份有限公司　　金额单位：人民币元

募集资金总额：2,420,000,000.00	已累计使用募集资金总额：2,217,558,400.79
募集资金净额：2,232,626,183.24	各年度使用募集资金总额： 2023年使用：1,172,754,496.03 2024年使用：879,080,717.41 2025年度使用：162,783,301.74 2026年1-9月使用：2,939,885.61
变更用途的募集资金总额：不适用	
变更用途的募集资金总额比例：不适用	

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	颀中先进封装测试生产基地项目	颀中先进封装测试生产基地项目	969,737,500.00	969,737,500.00	954,669,717.55	969,737,500.00	969,737,500.00	954,669,717.55	-15,067,782.45	已结项
2	颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目	颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目	500,000,000.00	500,000,000.00	509,732,288.83	500,000,000.00	500,000,000.00	509,732,288.83	9,732,288.83	已结项
3	颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目	颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目	94,594,500.00	94,594,500.00	96,572,281.49	94,594,500.00	94,594,500.00	96,572,281.49	1,977,781.49	已结项

4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	补充流动资金及偿还银行贷款项目	435,668,000.00	435,668,000.00	437,366,611.25	435,668,000.00	435,668,000.00	437,366,611.25	1,698,611.25	不适用
小计			2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,998,340,899.12	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,998,340,899.12	-1,659,100.88	——
1	超募资金	永久补充流动资金	不适用	138,000,000.00	138,014,993.35	不适用	138,000,000.00	138,014,993.35	14,993.35	不适用
2	超募资金	回购公司股份	不适用	94,626,183.24	100,399,927.73	不适用	94,626,183.24	100,399,927.73	5,773,744.49	不适用
小计				232,626,183.24	238,414,921.08		232,626,183.24	238,414,921.08	5,788,737.84	
合计			2,000,000,000.00	2,232,626,183.24	2,236,755,820.20	2,000,000,000.00	2,232,626,183.24	2,236,755,820.20	4,129,636.96	

注 1：上表“实际投资金额（含存款利息）”按各募投项目实际使用的募集资金（含使用的募集资金专户利息）填列；“已累计使用募集资金总额”仅统计募集资金本金，不含存款利息投入，也不含发行费用，两者差额 19,197,419.41 元系各项目使用的专户利息，其中：颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目 9,732,288.83 元、颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目 1,977,781.49 元、补充流动资金及偿还银行贷款项目 1,698,611.25 元、超募资金永久补充流动资金项目 14,993.35 元、超募资金回购公司股份 5,773,744.49 元。

附件 2

合肥颀中科技股份有限公司

前次募集资金（2023 年首次公开发行股份募集资金）投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2026 年 9 月 30 日

编制单位：合肥颀中科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2026 年 1-9 月	2025 年	2024 年		
1	颀中先进封装测试生产基地项目	不适用	32,981.73	9,517.71	-821.41	-8,603.59	92.70	否[注 1]
2	颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目	不适用	20,995.84	-413.98	11,258.95	11,366.48	26,848.39	是
3	颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 2]
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]
合计								——

注 1：颀中先进封装测试生产基地项目累计实现效益 92.70 万元，承诺的累计效益为 32,981.73 万元；主要系自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施，受限于设备境外采购及供应商的产能因素，设备交付较原预计时间有所延后，且客户认证周期较长，受此影响，公司募投项目建设进度在一定程度上有所延缓。项目原计划于 2023 年 9 月完成，延期至 2024 年 12 月，2024 年和 2025 年均处于产能爬坡阶段，因此未能实现预计效益。2026 年 1-9 月，随着客户的持续导入，项目当期实现效益 9,517.71 万元。

注 2：该项目无法单独核算效益。

注 3：该项目无法单独核算效益。

附件 3

合肥颀中科技股份有限公司

前次募集资金（2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金）使用情况对照表

截止日期：2026 年 9 月 30 日

编制单位：合肥颀中科技股份有限公司　　金额单位：人民币元

募集资金总额：850,000,000.00	已累计使用募集资金总额：607,339,709.43
募集资金净额：838,790,094.34	各年度使用募集资金总额： 2025年使用：75,776,761.33 2026年1-9月使用：531,562,948.10
变更用途的募集资金总额：不适用	
变更用途的募集资金总额比例：不适用	

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高脚数微尺寸凸块封装及测试项目	高脚数微尺寸凸块封装及测试项目	419,000,000.00	410,790,094.34	285,449,164.42	419,000,000.00	410,790,094.34	285,449,164.42	-125,340,929.92	2027-6-30
2	颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目	颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目	431,000,000.00	428,000,000.00	321,890,545.01	431,000,000.00	428,000,000.00	321,890,545.01	-106,109,454.99	2027-3-31
合计			850,000,000.00	838,790,094.34	607,339,709.43	850,000,000.00	838,790,094.34	607,339,709.43	-231,450,384.91	

注 1：公司于 2026 年 1 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目

拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）。

注 2：上表“已累计使用募集资金总额”不含发行费用。

附件 4

合肥颀中科技股份有限公司

前次募集资金（2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金）投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2026 年 9 月 30 日

编制单位：合肥颀中科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2026 年 1-9 月	2025 年	2024 年		
1	高脚数微尺寸凸块封装及测试项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								——

注 1：上述项目尚未结项。